

Approved  
International  
Event

时间 | 2025.10.28-30

地点 | 深圳国际会展中心（宝安）

# 亚洲电子生产设备暨 微电子工业展览会 NEPCON ASIA 2025

市场推广计划 Marketing Plan-EP



主办单位：  
ORGANISED BY



RX 励展博览集团  
同励百业·共展商机

同期举办：  
HELD IN CONJUNCTION



## 电动汽车

2024年中国成为全球首个新能源汽车产销量年度达**1,000万辆**的国家！2025年有望达到**1,500万辆**，渗透率超过55%！

## 新能源-逆变器

预计2025年全球光伏逆变器市场规模将达到约**663亿元人民币**。国内逆变器市场空间约为**116亿元**，海外市场空间约为**548亿元**。光伏逆变器出货量预计将达到**327GW**。

## 半导体封装

预计2025年中国集成电路封装测试市场规模将达到**1,200亿元人民币**，同比增长约15%。2025年广东省半导体及集成电路产业年主营业务计划收入突破**4,000亿元**，年均增长超过22%。

## AI+智能终端

**AI + 眼镜**: 2025年全球出货量预计将达到**400万副**，到2030年，全球AI眼镜出货量有望增长至**8,000万副**。

**AI + 玩具**: 预计到2030年，全球AI玩具市场规模将飙升至**351.1亿美元**，年复合增长率超过16%。

**AI+手机**: 2025年智能手机全球出货量将达到**12.7亿部**。2024年AI手机出货量占整体手机出货量的比重将达到11%，到2027年将攀升至**43%**。

**AI+PC**: 2025年全球AI PC出货量将达到**1.14亿台**，同比增长**165.5%**。



## 具身智能机器人

2025年全球人形机器人市场销量有望达到**1.24万台**，市场规模**63.39亿元**。到2030年全球人形机器人市场销量将接近**34万台**，市场规模将超过**640亿元**；2025深圳最新政策，计划至2027年：实现十亿级应用场景落地**50个**以上，关联产业规模达到**1,000亿元**以上，具身智能机器人产业集群相关企业超过**1,200家**。

## 低空飞行- eVTOL

2024年中国eVTOL市场规模约为**32亿元**，2025年将增至**57.5亿元美元**。

**AI+服务器**: 2025年全球AI服务器市场价值将达到**2,980亿美元**，2024年，中国AI服务器市场规模达到了**190亿美元**，增长了87%，**出货量更是超过了40万台**。预计到2028年，中国AI服务器市场规模将超过**550亿美元**。

**2025深圳最新政策，计划至2027年**: 全市人工智能终端产业规模达**8000亿元**以上、力争1万亿元，集聚不少于**10家**现象级人工智能终端企业，人工智能终端产品产量突破**1.5亿台**，推出**50款**以上爆款人工智能终端产品，打造**60个**以上人工智能终端典型应用场景。

## 智链电子新生态，跨界全球新商机！

Connect the Future,  
Smart Manufacturing Ecosystems,  
Global Opportunities

Hall 9号馆

**SFACTORY**  
工业4.0  
智能制造

Hall 11 Hall 13 号馆

**NEPCON** ASIA | **ufi** Approved International Event

Hall 15号馆

**ES SHOW**  
深圳国际电子元件及物料采购展览会

**AWC**  
深圳国际新能源汽车产业展览会



国展站  
Shenzhen World

Hall 10 Hall 12 Hall 14 号馆

国际薄膜与胶带展  
FILM & TAPE

国际全触与显示  
C-TOUCH & DISPLAY

**ufi** Approved International Event

**COMMERCIAL**  
DISPLAY

**COMMERCIAL**  
DISPLAY

**AWC**  
深圳国际新能源汽车产业展览会



国展北站  
Shenzhen World North

**AWC**  
深圳国际新能源汽车产业展览会

## 9号馆



### 观众目标市场

观众类型: EMS、OBM、电子设备商  
部门: 管理层、AE自动化工程部、组装部、  
工艺改良部、品保部、测试部、生产部、制造  
部、设计研发-生产部、设备部采购部

## 15号馆



### 观众目标市场

观众类型: EMS、OBM、元器件经销代理  
商  
部门: 设计研发部、采购部

## 11、13号馆



### 观众目标市场

观众类型: EMS、OBM、OSAT  
部门: 管理层、SMT部、PCBA部、生产部、  
制造部、设计研发-生产部、设备部、工艺改良  
部、品保部、测试部、采购部

## 15、16号馆



### 观众目标市场

观众类型: 整车厂、一供应商、核心汽车零部  
件生成制造商、系统解决方案商、研究院等  
部门: 设计研发部

## 10、12、14号馆



### 观众目标市场

观众类型: Mini LED制造商、商显制造商、面板制造商、薄膜制造商  
部门: 生产部

- NEPCON ASIA汇聚亚洲全品类电子生产企业买家，综合呈现全球电路板组装、智慧工厂、半导体封测、汽车制造、触控显示等跨行业先进生产解决方案。助力客户高效捕捉新商机，拓展新领域，精准对接新客户，促成产业链上下游的深度商业合作，全面提升亚洲电子制造企业的全球竞争力。



## 2025年预计展会规模



70,000+  
专业观众

1,800+  
国际观众

40+  
现场活动



80,000 sqm  
展示面积

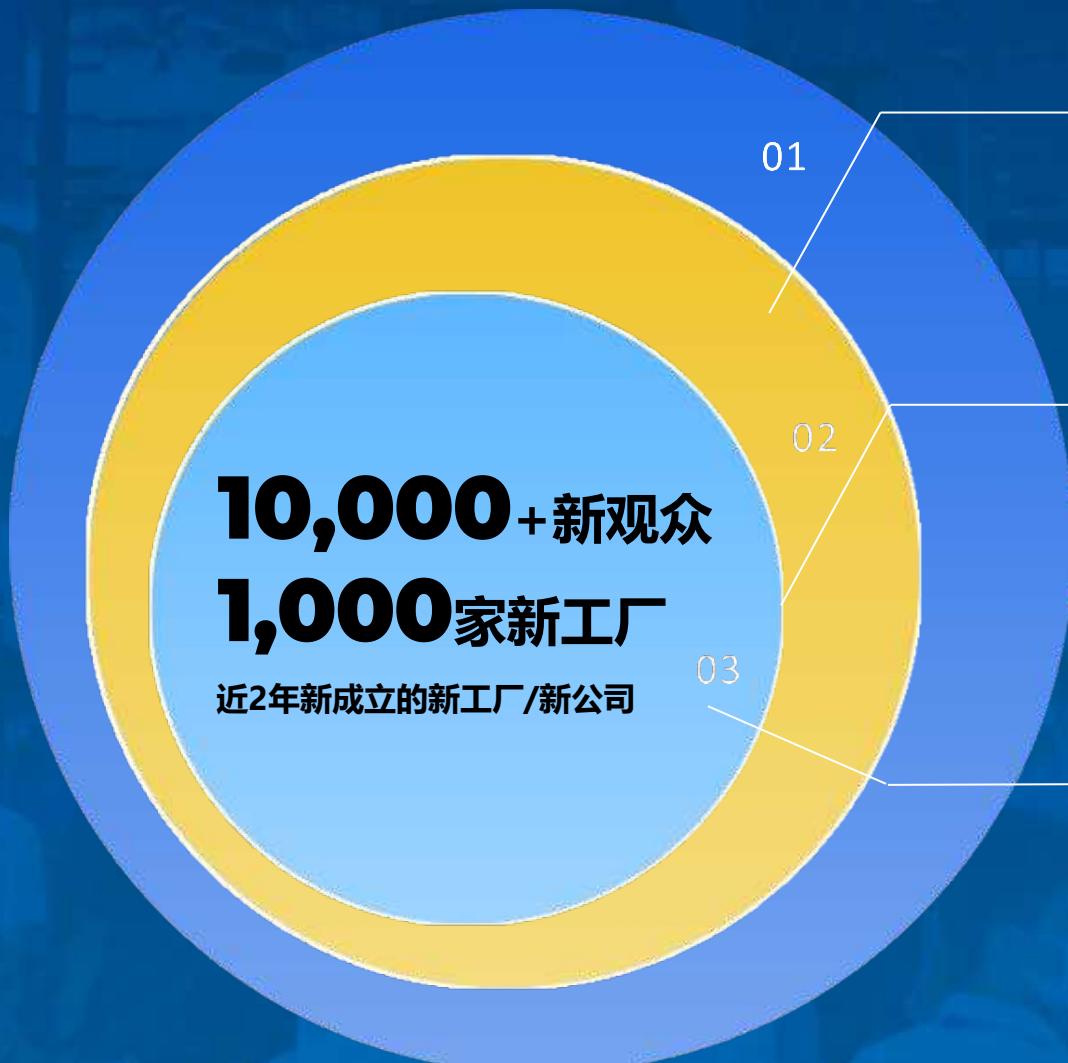
600+  
参展企业

3+  
国际展团

- 电子制造解决方案供应商的重要销售渠道
- 365天全年多元化渠道链接新买家、新客户
- 聚焦新兴产业，开拓新领域、新机遇
- 汇聚亚洲地区海外买家，拓展海外业务
- 展示电子制造先进技术解决方案

# 2025 NEPCON ASIA

## 新买家计划



01  
高增长行业  
新业务  
13,000+汽车电子买家  
3,550+ 新能源买家  
3,000+ 半导体封测买家

02  
未来赛道  
新商机  
人工智能买家  
1,500人 低空飞行买家  
人形机器人买家

03  
核心领域  
新买家  
1,000+家  
新成立工厂/新公司

# 2025 NEPCON ASIA 观众目标

## 按观众感兴趣产品的观众占比

	自动化	PCBA+半导体封测	电子元器件
目标观众种类	EMS工厂 (包含TOP50) OBM工厂 ODM工厂 OEM工厂 经销/代理/贸易商 自动化设备厂商 (同期展及板块展商)	EMS工厂 (包含TOP50) OBM工厂 ODM工厂 OEM工厂 经销/代理/贸易商 半导体封测厂、晶圆厂、 IC设计公司含有SIP工艺产线的EMS工厂	EMS工厂、OBM工厂、ODM工厂、OEM工厂 原厂设计 (有定制元器件需求买家)
目标观众部门	管理层、AE自动化工程部、组装部、工艺改良部、品保部、测试部、生产部、制造部、设计研发-生产部、设备部采购部	管理层、SMT部、PCBA部、生产部、制造部、设计研发-生产部、设备部、工艺改良部、品保部、测试部、采购部	管理层、采购部、资材部、物料部、设计研发部
预计到场人数 (70,000+)	15,000+	45,000+	10,000+
预计占比	21%	65%	14%

# 2025 NEPCON ASIA

## 展会价值与亮点

### 01 高增长行业新买家

**1,000+**全新买家！

来自近2年新成立的电子产品新工厂。

**10,000+**高增长应用领域新买家！

来自汽车电子、半导体、新能源（逆变器&锂电电控等零部件企业）

**1**条半导体封测产线+**1**个工艺车间，精准面向 **200+**OSAT及IDM企业！

商业性

国际性

**1,800+**位海外买家

(重点目标国家：越南、马来西亚、泰国、印尼)

海外专场采配会+国家日活动+工厂参观，推动中外对话，技术交流！

### 02 未来产业潜在买家

瞄准低空飞行+具身机器人+人工智能

**3大千亿级**新兴赛道，打造亮点展示

区，预计转换**1,500+**新买家出席，共同探索未来电子新趋势！

前瞻性

多元性



### 04 国内多元化买家

全年度多元对接：月度线上采配会、主题路演、**7**大细分主题采配会等助力赢得订单！

同期举办**6**大旗舰展，覆盖汽车、电子、屏幕与新材料**4**大行业3500+展商，80+会议活动，165,000专业观众

## 抢抓商业新订单，寻找新的增长点！



### 核心领域 - 新资源

- 近2年成立的新工厂/新公司
- 近2年新扩增产线/新项目



### 高增长行业 - 新业务

- 高增长应用领域新买家
- 汽车电子、半导体、新能源（逆变器&锂电电控）等

近2年成立的新工厂/新公司		
所属省份	企业名称	成立日期
广东	惠州市鑫辉电子有限公司	2023-03-22
广东	深圳音视控科技有限公司	2023-07-10
广东	佛山市禅城区优能仕电子厂	2023-02-28
广东	深圳市捷田科技有限公司	2023-05-10
广东	深圳市汇鑫铖科技有限公司	2023-07-05
广东	深圳市科安捷电子技术开发有限公司	2023-06-16
广东	深圳市龙岗区横岗街道力宏五金厂	2023-02-22
广东	河源市江东新区皓康电子塑胶加工厂	2023-04-10
广东	深圳优泰显示科技有限公司	2023-06-01
广东	深圳市月博鑫电子科技有限公司	2023-07-10
广东	深圳市晖君科技有限公司	2023-04-21
广东	深圳市锐财科技有限公司	2023-03-28

近2年成立的新工厂/新公司		
所属省份	企业名称	成立日期
广东	弗安新技术（深圳）有限公司	2023-02-17
广东	深圳市好猫电子有限公司	2023-05-25
广东	承毅祥（深圳）电子科技有限公司	2023-06-21
广东	佛山市顺德区卓星耀智能设备厂	2023-06-02
广东	河源市和平县晨旭线材电子厂	2023-07-26
广东	汕头市澄海区佳尚电子厂	2023-08-09
广东	广西想象力数码有限公司	2023-12-01
广东	烜赫科技（中山）有限公司	2023-11-15
广东	东莞市慧之宇电子有限公司	2023-09-07
广东	恩平市影阳电子有限公司	2023-08-25
广东	佛山市迈泰汽车用品有限公司	2023-04-25
广东	恩平市声美电子科技有限公司	2023-03-09

# 01 高增长行业新买家：扩产线、新工厂

NEPCON  
MICROELECTRONICS  
ASIA  
亚洲电子生产设备及微电子工业展览会

UFI  
Approved  
International  
Event

## (部分) 2024-2025扩产线、新工厂

地区	公司名称	核心产品	项目内容	预计投产时间	投资金额
广东东莞	歌尔股份	智能耳机、VR设备	新建智能制造工厂	2024年底	50亿元人民币
广东广州	广州华星光电技术有限公司	高世代液晶面板、OLED屏幕	新建第8.5代OLED产线	2025年Q1	300亿元人民币
广东广州	广州粤芯半导体	新建12英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目 (三期)	新建封装产线	2025年Q1	30亿元人民币
广东惠州	亿纬锂能	动力电池、储能系统	扩建动力电池产线	2025年Q1	60亿元人民币
广东汕头	汕头比亚迪实业有限公司	脚垫生产线, 充电桩枪生产线、二合一随车充生产线、下护板生产线	比亚迪汽车精品产业项目	未知	7亿人民币
广东深圳	比亚迪电子	新能源汽车电子部件、智能硬件	新建智能工厂, 扩充产线	2025年Q2	100亿元人民币
广东中山	芯深电子	PCB高多层线路板、HDI板及高端金属板, 芯片封测	新项目	2025年2月	16亿元
广东中山	元亨光电(大湾区)智能制造总部基地	Mini LED	新建工厂	2024年10月	4亿元
广东广州	广州光电存算芯片融合创新中心	光电子和微电子芯片的晶圆级制造工艺和封装测试	新建工厂	2025年4季度	200亿元
广东东莞	东莞市通科电子有限公司	汽车半导体	新项目	2026年	10.5亿元
广东珠海	珠海冠宇电池	锂电池、储能电池	新建电池生产线	2025年初	80亿元人民币
湖北武汉	武汉华星光电技术有限公司	第5.5代印刷OLED显示面板线	OLED产线	2024年Q4	180亿元人民币
湖北武汉	长飞先进武汉基地	碳化硅芯片	新工厂	2025年5月	200亿元
湖南长沙	长沙比亚迪电子	高端智能手机	长沙比亚迪电子二期项目	2024/11/30	10亿元
江苏无锡	长电科技	高端封装 (如3D封装、SIP)	新建高端封装产线	2025年Q2	50亿元人民币
南通	制局半导体 (南通) 有限公司	先进封装 (Chiplets) 模组制造项目	新项目	2025年2月	10.5亿元
上海	御微半导体	设备研制项目	新项目	未知	8亿元
四川成都	成都京东方光电科技有限公司	OLED显示屏	新建第6代柔性OLED产线	2024年底	465亿元人民币
苏州	苏州宝士曼半导体设备有限公司	率半导体、先进封装技术及新能源应用	第三代半导体及集成电路专用设备	2024年	10亿元
苏州	哈曼苏州车载显示工厂	全贴合生产线、背光模组组装线、液晶显示模组组装和测试线、自动化包装生产线等全自动化车载液晶显示模组生产线	新项目	2025年2月	1亿元
浙江	富庆淇芯 (浙江) 科技有限公司	半导体大功率器件生产		未明确	55.44
浙江	浙江晶能微电子有限公司	车规级半导体封测基地项目	扩建封装产线	2024年6月投产	未明确
浙江	浙江星柯光电二期	MLed新型显示模组、柔性显示器件	新建工厂	2024年12月	190亿元
浙江	狮门半导体	导体功率器件	新项目	45383	4亿元
安徽合肥	肥维信诺科技有限公司	OLED显示屏	新建第6代柔性OLED产线	2025年初	200亿元人民币
北京	北京电控集成电路制造有限责任公司	12英寸集成电路生产线		2026年底	330

\* 以上名单来自网络, 持续更新中

# 01 高增长行业新买家：扩产线、新工厂

NEPCON  
MICROELECTRONICS  
ASIA  
亚洲电子生产装备及微电子工业展览会

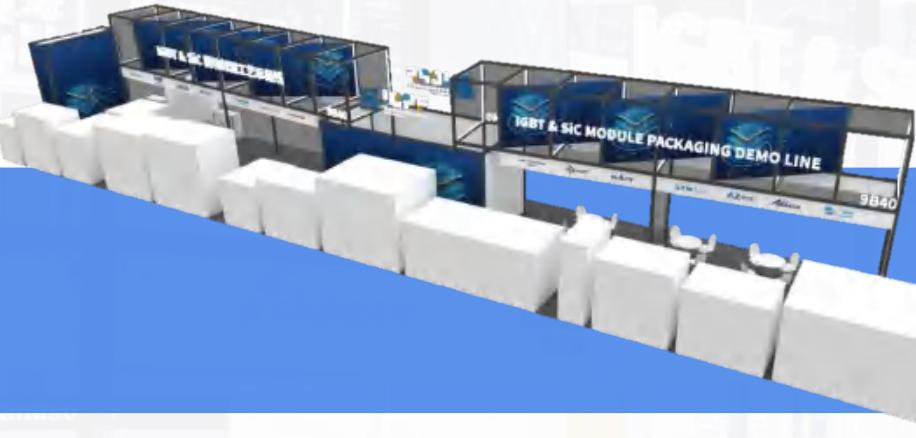
UFI  
Approved  
International  
Event

## 2024广东省重点项目-投产、续建、新开工项目

类型	项目单位	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)
投产	广州科骅科技创新投资有限公司	广东盈骅总部和微处理芯片封装载板项目	建筑面积约12.7万平方米，建设产业研发办公大楼、厂房	95470
投产	惠州中晟泰科技有限公司	仲恺中晟泰科光电子元器件生产建设项目	建设集成电路、半导体等相关高精尖电子信息产品的研发与生产总基地	80000
投产	广东韶华科技有限公司	韶华科技集成电路及新型显示器件先进封测产业化项目	建筑面积10万平方米，建设生产厂房、动力站、宿舍、门卫室、杂品库和相关配套设施	97000
续建项目	高劲 (广东) 芯片科技有限公司	顺芯城 (容桂) 高端芯片基地	建筑面积34.61万平方米，建设厂房、办公楼及相关配套设施	103000
续建项目	安世半导体 (中国) 有限公司	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	建筑面积1.4万平方米，生产半导体分立器件及半导体功率器件，年产量78亿粒	180800
续建项目	东莞市中晶松湖光电子技术有限公司	广东光大第三代半导体科研制造中心2区	建筑面积38万平方米，MiniLED COB显示模组生产线厂房、研究院、中试中心等	560000
续建项目	中山芯承半导体有限公司	中山芯承半导体有限公司年产高密度倒装芯片封装基板106万片项目	从事高密度倒装芯片封装基板产品生产，年产高密度倒装芯片封装基板产品106万片	100000
续建项目	佛山市国星光电股份有限公司	佛山市国星光电LED器件封装及其应用产品项目	建设厂房，设置LED封装生产线	190000
续建项目	广州兴森半导体有限公司	广州兴森半导体有限公司集成电路FCBGA封装基板项目	建筑面积28万平方米，建设高端集成电路FCBGA封装基板智能制造工厂等	600000
续建项目	广州增芯科技有限公司	12英寸先进智能传感器及特色工艺晶圆制造产线项目	建筑面积约19万平方米，建设一条12英寸MEMS传感器代工产线，月产能2万片	800000
续建项目	深圳市鹏芯微集成电路制造有限公司	集成电路制造线项目	建筑面积约35万平方米，建设厂房测试车间、办公楼、检测间、变电站、大宗气站等	4810000
续建项目	深圳市鹏进高科技有限公司	先进功率器件工业园	建筑面积为9.6万平方米，建设软件工厂、洁净中试厂房等	357146
续建项目	高劲 (广东) 芯片科技有限公司	顺芯城 (容桂) 高端芯片基地	建筑面积34.61万平方米，建设厂房、办公楼及相关配套设施	103000
投产	广东兴芯半导体有限公司	广东兴芯集成电路专案项目	建设月产能为9.6万颗封装载板产线	70000
投产	广州广芯封装基板有限公司	广州广芯半导体封装基板产品制造项目	厂房建筑面积33万余平方米，建设半导体封装基板项目，生产FC-BGA等封装基板	600000
投产	珠海越芯半导体有限公司	珠海越芯高端射频及FCBGA封装载板生产制造项目 (一、二期)	建设高端集成电路FCBGA封装基板智能制造工厂以及相应的公辅设施	267165
投产	广州华星光电半导体显示技术有限公司	广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目	建筑面积127万平方米，建设第8.6代，氧化物半导体显示面板生产线及配套模组工厂	3500000
续建项目	东莞市天域半导体科技有限公司	东莞市天域半导体科技有限公司总部及生产制造中心建设项目	建筑面积约19万平方米，建设生产厂房、研发大楼、办公大楼、仓库等	467000
续建项目	东莞市中晶松湖半导体科技有限公司	广东光大第三代半导体科研制造中心1区	建筑面积约28万平方米，精密半导体设备制造、氮化镓衬底生产线等	440000

\* 以上名单来自网络，持续更新中

精准触达 200+家OSAT & 含封测车间IDM买家!



## ● 半导体封测示范线

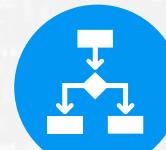
- ① 集成电路及先进封测车间展示区
- ② IGBT & SiC模块封测工艺示范线



1条产线  
+1个工艺车间



50+家  
材料及检测品牌



80+个  
设备工位

## ● ICPF半导体技术和应用创新大会

- ① 集成电路及先进封装封装工艺大会
- ② 功率半導创新应用及技术大会

### [拟邀听众]

- OSAT工程部、制造部
- IDM自有封测车间工程部、制造部
- IDM研发设计

# 01 高增长行业新买家 - 半导体目标买家



Approved  
International  
Event

## 华南地区封测厂企业名单 (部分)

中山市天微电子有限公司  
正芯半导体技术 (深圳) 有限公司  
肇庆华微电子有限公司  
深圳长晶半导体有限公司  
香港天微电子科技有限公司  
深圳芯德科技有限公司  
深圳硕贝德无线科技有限公司  
深圳市新汇成科技有限公司  
深圳市芯德微电子科技有限公司  
深圳市芯德半导体科技有限公司  
深圳市万年芯电子有限公司  
深圳市天微电子股份有限公司  
深圳市赛微电子有限公司  
深圳市明微电子股份有限公司  
深圳市晶方科技有限公司  
深圳市金誉半导体集团  
深圳市硅格电子有限公司  
深圳市硅格半导体有限公司  
深圳市高格芯微电子有限公司  
深圳平晶微电子科技有限公司  
深圳利普芯微电子有限公司  
深圳佰维存储科技股份有限公司  
上海晶丰明源半导体股份有限公司深圳分公司  
气派科技股份有限公司

## 华南地区封测厂企业名单 (部分)

康佳芯盈半导体科技 (深圳) 有限公司  
捷捷微电 (深圳) 有限公司  
江西万年芯微电子有限公司深圳分公司  
惠州长晶科技有限公司  
惠州硕贝德无线科技股份有限公司  
惠州硕贝德电子有限公司  
惠州硕贝德半导体材料有限公司  
惠州市华达微电子有限公司  
惠州佰维存储科技有限公司  
环旭 (深圳) 电子科创有限公司  
环胜电子 (深圳) 有限公司  
华润股份有限公司  
海南汉威科技有限公司  
硅格国际科技 (深圳) 有限公司  
广州硕贝德科技有限公司  
广州市环旭电子有限公司  
广州市华微电子科技有限公司  
广州华微电子有限公司  
广州华润电子有限公司  
广西天微电子有限公司  
广东长电科技有限公司  
广东扬杰电子科技有限公司  
广东气派科技有限公司  
广东利扬芯片测试股份有限公司

## 华南地区封测厂企业名单 (部分)

長晶科技 (香港) 有限公司  
富满微电子集团股份有限公司  
东莞天微电子有限公司  
东莞市扬杰科技有限公司  
东莞市明微电子科技有限公司  
东莞市金誉半导体有限公司  
东莞市华微电子科技有限公司  
东莞市汉威科技有限公司  
东莞平晶微电子科技有限公司  
东莞利扬芯片测试有限公司  
比亚迪半导体股份有限公司  
统懋半导体 (深圳) 有限公司  
深圳市南科功率半导体有限公司  
深圳市旭昌辉半导体有限公司  
深圳市壹芯微科技有限公司  
深圳市育诚先进半导体有限公司  
广东汉瑞通信科技有限公司  
深圳市东飞凌科技有限公司  
深圳市固得洪克电子有限公司  
微硕半导体 (深圳) 有限公司  
深圳市华晶微电子有限公司  
星威国际

## 重点EMS/OBM (含SiP工艺)

长虹精密中山公司  
中达电子(江苏)有限公司  
长虹电子  
采埃孚汽车  
Intel亚太研发中心  
华为技术有限公司  
华为  
联合汽车电子有限公司  
南京奥托立夫汽车安全系统有限公司  
珠海格力电器  
加达利汽车电子(广州)有限公司  
深圳市富士康科技集团有限公司  
伟创力(深圳)科技有限公司  
捷普集团深圳医疗有限公司  
新美亚电子 (深圳) 有限公司  
贝莱胜电子(杭州)有限公司  
上海豪港网络信息科技有限公司  
重庆川仪微电路有限责任公司  
英业达科技有限公司  
鸿通电子  
广达电脑  
欧朗集团  
深圳市裕华硕科技有限公司  
立讯精密科技有限公司  
Foxconn  
广上科技(广州)有限公司  
上海英业达有限公司

## 前瞻布局新赛道，未来产业主题展示区全新发布！

人形机器人



### 具身机器人拆解区：

核心控制单元、传感器模块、执行器与驱动器、电源管理模块等核心零部件。核心部位控制电路组合展示。

### 机器人表演/演示区：

工业场景演示：机器人工厂工作，搬运

### 机器人研讨会

#### 【话题方向】

- 人形机器人产业的规模化、标准化和专业化发展
- 人形机器人精密制造工艺与材料创新
- 传感模块与人形机器人交互性能优化

低空经济



### eVTOL低空飞行器拆解区

传感器模块、通信模块、电机驱动模块、电池管理系统等关键部件拆解展示，整机控制电路组合展示等。

### 低空经济论坛：

#### 【话题方向】

- 全球低空经济标准现状与趋势
- 低空飞行器电子控制系统的研发与创新
- 电子制造技术：驱动低空飞行器创新
- 智能传感器技术提升飞行器感知能力

## 未来产业主题拆解展示区：与PCBA相关联的供应链企业



### 人形机器人

空心杯电机	无框力矩电机
鸣志电器	步科股份
伟创电气	卧龙电驱
苏州钧川科技	昊志机电
鼎智科技	伟创电气
拓邦股份	雷赛智能
兆威机电	禾川科技
禾川科技	科尔摩根
力矩传感器	无线通信模块
柯力传感	广和通
昊志机电	高通 (Qualcomm)
安培龙	华为 (Huawei)
坤维科技	博海智联
宇立仪器	乐鑫科技
蓝点触控	飞睿智能
杭州凯维力传感	兴颂HinSon
八方股份	鲁渝能源



### 低空经济

整机厂商
亿航智能 (EHang)
小鹏汇天
上海峰飞 (AutoFlight)
吉利集团
亿维特
广汽研究院
时的科技
沃飞长空 (Aerofugia)
中国商飞 (COMAC)
御风未来 (Vertaxi)
零重力飞机工业
倍飞智航
大疆创新 (DJI)
极飞科技
纵横股份
航天彩虹
隆鑫通用



### Ai 人工智能

Ai 眼镜	Ai 服务器
Rokid	浪潮信息
XREAL (优奈柯恩)	戴尔
INMO (深圳影目)	联想
枭龙Xloong	新华三
Oculus (傲库路思)	宁畅
Vuzix Corporation	安擎
瑞欧威尔	坤前
谷东科技	华为
雷神科技	宝德
Ai 宠物	Ai PC
Vanguard Industries	联想
宇树Unitree	惠普
跃然创新	宏碁
Boston Dynamics	华硕
AGELESS INNOVATION	戴尔
LOVOT	华为
萌友智能 (Ropet)	荣耀
可立宝Loona	AMD

## 拓展国际新业务，塑造国际竞争力！

**NEPCON ASIA 2025**将联动NEPCON系列兄弟展，同时通过与VEIA越南电子行业协会、印尼电子协会、泰国分包促进协会等海外协会与媒体深度协作，通过观众组团及落地国家日系列沙龙活动。强势汇聚500+海外公司，约1,800名国际买家！



### 国家日活动

- 举办时间：2025.10.28-29
- 语言：英语
- 形式：开放式
- 话题方向：  
以国家日呈现，海外观众组团出席，  
由中国厂商面向精准海外采购商进行  
最新产品以及技术分享。



### 工厂参观

- 举办时间：2025.10.28-29
- 形式：名单审核制度
- 话题方向：  
组织四大目标国家观众前往参展商工厂  
进行实地考察与商务交流。有效的  
品牌曝光，企业风采的展现。



### 海外专场1v1商贸配对

- 举办时间：2025.10.28-30
- 深度海外买家采购需求，技术难点，定向推送国产化替代方案。
- 商贸导览团、1v1商贸配对多元化形式全面促进双向奔赴。

### SMTA华南高科技技术工作坊

- 举办时间：2025.10.29
- 特邀中、美、日、泰等多地技术专家打造一个真正的具有全球视角的SMT国际技术交流会，促进全球电子制造技术发展与升级。

## 365天营销新计划，全渠道拓展新生意！

### 高增长 应用行业路演

展会主办城市以外的地区举行路演，  
小规模**专场展示+研讨沙龙+商贸配对**形式，为参展商打开精准区域市场！

### 线上&线下 主题采配会

#### 2000+商贸配对

- 展前：月度线上采配会 **500+**  
时间：**5、6、7、8月**  
形式：线上语音、视频、微信群组对接
- 展中：7大细分主题采配会 **1,500+**  
时间：**2025.10.28-30**  
形式：展商展台对接+导览+一对一配对间对接。



### 数字营销， 线上推广渠道

展会通过多元化渠道整合营销，  
EDM、SMS、新媒体、死于社群等  
多渠道为企业宣传曝光，  
全年汇聚超过**2,000+**条  
行业情报 & 销售线索分享

### NEPCON 专业展会+丰富现场活动

超30年的发展，  
已经成为**亚洲地区PCBA旗舰展**，  
电子制造展圈每年必打卡展会项目！  
全面展示电子制造全产业链产品及解决方案，  
是企业宣传推广，提高品牌知名度，获取新  
订单的不二之选！



- 配对形式: 线上 (视频、语音、微信群组)
- 场次目标: **500+场**

月份	应用行业主题	服务展商	TAP买家	预计配对场次
5月	EMS、汽车电子、新能源	20-30家	30-40家 (新买家: 10家)	120+
6月	EMS、半导体	20-30家	30-40家 (新买家: 10家)	120+
7月	电子生产设备专用设备厂商	20-30家	30-40家 (新买家: 10家)	130+
8月	新买家+AI+低空经济+机器人	20-30家	30-40家 (新买家: 20家)	130+



## ● 展中: 七大主题采配会



### 展中商贸配对**1,500+场**

- 国内TAP配对1,200场, 国际TAP配对300场
- TAP到场目标: 1,600 人
- 海外TAP目标: 200 人
- (重点国家: 越南、马来西亚、泰国、印尼)

新买家500人

细分主题	服务展商
海外技术设备专场采配会 (越、马、泰、印)	20-30家
新能源专场采配会 (电源、储能、电控、逆变器)	20-30家
汽车电子采配会 (域控制器、电子电器零部件企业)	20-30家
【ES SHOW专场】电子元器件采配会	20-30家
【自动化专场】电子生产设备专用设备厂商采配会	20-30家
【半导体封测专场】半导体制造采配会 (OSAT)	20-30家
【新买家专场】新成立+AI+低空经济+机器人	20-30家

NEW

## 04 多元跨界新商机，挖掘更多潜力商业领域！

同期举办6大旗舰展，覆盖汽车、电子、屏幕与新材料四大主要行业，汇聚不同环节的参展商，促进了上下游企业之间的直接交流与合作，为技术创新、产品研发和市场拓展提供了广阔空间。这种跨领域的交流有助于激发新的创意和商业模式，同时超大规模，将吸引更多主办城市以外地区的买家出席。

**160,000<sup>m<sup>2</sup></sup>**  
展示面积



观众来自  
**90+**  
国家及地区



**165,000+**  
专业观众

**10,000+**  
TAP特邀贵宾买家

**80+**  
现场活动



近  
**3,500**  
参展企业

**5,000+**  
海外观众



# 2025 展会现场活动

NEPCON  
MICROELECTRONICS  
ASIA  
亚洲电子生产设备及微电子工业展览会

UFI  
Approved  
International  
Event



## 电子制造

论坛  
会议

SMTA 华南高科技术研讨会  
华南高科设备研讨会  
SMTA 华南高科技术工作坊(全球电子生产技术交流)

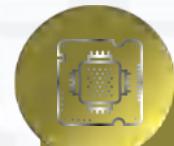
赛事活动

电子和远程信息处理行业商业论坛  
电子制造ESG可持续发展论坛  
NEPCON 电子智造抖音达人交流会  
电子焊接项目竞赛-“快克杯”全国电子制造行业焊接技能大赛  
“ESAMBER 岱博杯”全国电子制造行业板级故障分析与维修技能大赛

国际商务  
交流

“望友杯”全国电子制造行业PCBA 设计大赛  
“海承杯”全国电子制造行业线束线缆制作工艺与操作技能大赛

国家日-中国电子制造及智能工厂技术研讨会 ①SMT技术专场



## 半导体

论坛  
会议

2025第八届ICPF 半导体技术和应用创新大会-论坛①集成电路及先进封测  
2025第八届ICPF 半导体技术和应用创新大会-论坛②功率半导体技术及应用  
2025第八届ICPF 半导体技术和应用创新大会-论坛③光通讯 NEW

示范线  
&车间

①集成电路及先进封测车间展示区 NEW  
② IGBT & SiC模块封测工艺示范线 NEW  
③ 800G/1.6T光通模组封测工艺示范线 NEW



## 智慧工厂&自动化

国际商务  
交流

国家日-  
中国电子制造及智能工厂技术研讨会 ②智慧工厂&自动化专场 NEW

论坛  
会议

**AI驱动的智慧工厂与自动化创新论坛**  
• AI技术如何驱动自动化设备的智能化升级  
• AI在智慧物流与柔性生产中的应用  
• AI技术如何助力工厂转型  
• AI质量检测 NEW

### 机器视觉论坛

AI+3D视觉、工业自动化、数字化车间、智能工厂 NEW



## 新兴/高增长应用行业论坛

汽车电子

### 智能汽车电子生产技术大会

(雷达、域控制器、传感器、电驱电控系统、车载充电桩 (OBC) 生产制造技术与创新) NEW

低空经济

### 低空飞行产业技术大会

(低空飞行器/飞行汽车/功率模块/控制模块等整机及零部件生产制造技术)  
• 电子制造技术赋能低空飞行器的智能化升级  
• 智能传感器技术提升飞行器感知能力 NEW

新能源

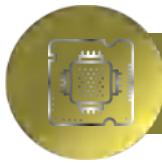
### 新能源产业电子技术及应用论坛

(光伏&储能逆变器、智能光伏控制器、储能BMS、智能监控模块、智能电网通信模块、分布式能源管理系统制造技术与创新)

具身机器人

### 具身智能机器人技术大会

(聚焦具身机器人本体、运动控制、无框力矩电机、六维力传感器、灵巧手等核心零部件的生成制造创新工艺与技术)



## 2025第八届 ICPF 半导体技术和应用创新大会

ICPF半导体技术和应用创新大会是半导体行业内的一场年度盛会，专注于探讨集成电路及先进封装工艺、功率半导体创新应用及技术、光电器件封测工艺三大核心主题。汇聚全球半导体领域的精英学者、企业高管及创新先锋，共同探索半导体技术的最新突破与应用趋势。通过深度剖析集成电路的前沿设计、制造工艺与封装技术，同时聚焦光电器件的封测工艺，为半导体行业的持续发展注入新动力。

- **举办时间:** 2025年10月28-30日
- **举办地点:** 展会现场 – 封测剧院
- **参会听众:** 200-600人
  - ① OSAT工程部、制造部
  - ② IDM自有封测车间工程部、制造部、研发设计部
  - ③ 3C、AI、低空飞行、汽车电子、锂电、电控、光伏相关等终端企业研发部、工程部等
  - ④ 半导体软件、设备及材料企业



1

### 细分主题1

#### 集成电路及先进封装封装工艺大会

- **话题方向:**
  - 先进封装行业的技术现状与发展趋势
  - 面板级封装在可穿戴设备、物联网设备等小型电子产品中的应用前景
  - 2.5D/3D封装技术最新进展
  - 高算力集成芯片演进
  - 人工智能与半导体封装的融合

2

### 细分主题2

#### 功率半导创新应用及技术大会

- **话题方向:**
  - 功率半导体应用新场景与发展趋势
  - 功率半导体材料的最新进展
  - 功率半导体封装技术的革新，跨3D
  - IGBT模块的封装工艺流程与质量控制
  - SiC MOS 在新能源汽车上的应用
  - 功率半导体测试技术革新

## 智能汽车电子生产技术大会



- 举办时间: 2025年10月28日 10:30-17:00
- 举办地点: 展会现场 – NEPCON 剧院
- 参会听众: 200人

据统计, 2024新能源汽车产销分别达1288.8万辆和1286.6万辆, 大增34.4%和35.5%。中国汽车电子市场规模预计超12000亿元。预测2025年, 随着智能化、电动化趋势加强, 汽车电子产业将持续扩大。

聚焦新能源汽车中雷达、域控制器、智能传感器、电驱电控系统、车载充电机(OBC)等核心零部件生产制造技术与创新分享。

### ■ 话题方向:

- 新能源汽车产业现状与发展机遇
- 汽车电子制造技术的前沿趋势与创新生态
- 汽车电子工艺与市场需求
- 域控制器如何作为汽车电子电气架构的核心
- 激光雷达技术革新与城市NOA全面实现
- 传感器与域控制器的协同工作
- 智能汽车电子生产中的数字化转型与智能制造

## 新能源产业电子技术及应用论坛



- 举办时间: 2025年10月29日 13:30-17:00
- 举办地点: 展会现场 – NEPCON 剧院
- 参会听众: 200人

得益于全球对清洁能源需求的增加和储能技术的快速发展。2024年新型储能装机规模已突破7000万千瓦, 预计2025年新型储能装机规模有望突破一亿千瓦。光储充一体化正从示范阶段迈向规模化商用, 预计2025年市场规模超2000亿元。

聚焦新能源产业中光伏&储能逆变器、智能光伏控制器、电池管理系统BMS、太阳能光伏模块, 智能监控模块、智能电网通信模块、分布式能源管理系统等核心零部件制造技术与创新分享。

### ■ 话题方向:

- 光储充一体化系统的技术创新与应用
- AI调度系统优化光-储-充协同
- 新型电力系统储能发展展望
- 逆变器核心零部件的技术创新与材料革
- 传感器技术在光储充系统中的精准监测与智能控制
- 逆变器技术创新与高效能源转换
- 光储充一体化系统中的热管理技术



## 低空飞行产业技术大会

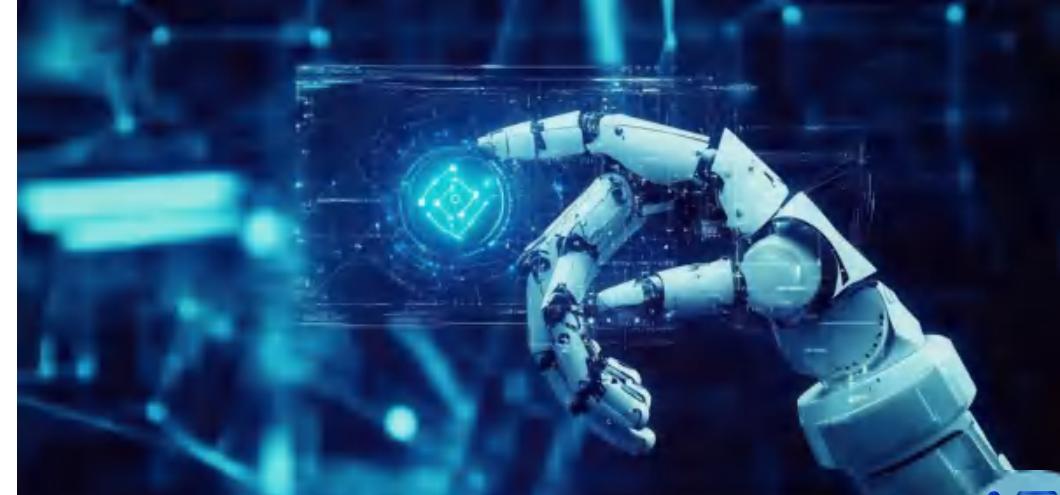


2024年中国低空经济市场规模预计达到5035亿元，中国民用无人机市场规模预计达到1765亿元，随着政策支持，靠技术创新加速，应用场景丰富，预计2025年中国低空经济市场规模将达到1.5万亿元左右，展现出巨大的市场潜力。

聚焦低空飞行器/飞行汽车/功率模块/控制模块等整机及零部件生产制造技术工艺创新、效率提升等。

### ■ 话题方向：

- 低空飞行产业生产制造前沿探索
- 载人电动垂直起降飞行器（eVTOL）关键技术
- eVTOL电子电力系统的安全性与可靠性
- 低空飞行器动力系统创新与升级
- 低空飞行器的高精度导航与定位技术
- 电子制造技术赋能低空飞行器的智能化升级
- 智能传感器技术提升飞行器感知能力



## 具身智能机器人技术大会



根据GGII（高工机器人产业研究所）的预测，2030年全球人形机器人市场规模突破200亿美元，中国市场规模达50亿美元（基于中国占全球服务机器人市场25%的测算）。

聚焦具身机器人本体、运动控制、无框力矩电机、六维力传感器、灵巧手等核心零部件的生成制造创新工艺与技术。

### ■ 话题方向：

- 具身机器人的发展机遇与挑战
- 人形机器人创新应用场景
- 智造未来：机器人技术如何重塑电子行业新生态
- 从硬件到软件的全面人形进化
- 视觉感知技术，驱动智能化升级的核心引擎
- AI驱动的具身机器人：技术挑战与未来展望



智链电子新生态，跨界全球新商机！

# 亚洲电子生产设备暨 微电子工业展览会 **NEPCON ASIA 2025**

市场推广计划 Marketing Plan

时间 | 2025.10.28-30

地点 | 深圳国际会展中心（宝安）

参展咨询：13918433027

